急速溶融成長法で作製された SiGe ワイヤの熱電特性

Thermoelectric Characteristic of SiGe Wires Fabricated by Rapid-Melting Technique

早大理工¹、名大院工²、学振特別研究員³、JST さきがけ⁴、 [○]熊田 剛大¹,中村 俊貴¹,富田 基裕¹,中田 壮哉²,高橋 恒太 ^{2,3},黒澤 昌志 ^{2,4},渡邉 孝信¹ Waseda Univ.¹, Nagoya Univ.², JSPS Research Fellow ³, JST-PRESTO⁴, ^oT. Kumada¹, T. Nakamura¹, M. Tomita¹, M. Nakata², K. Takahashi^{2,3}, M. Kurosawa^{2,4}, T. Watanabe¹

E-mail: kumada takehiro@watanabe.nano.waseda.ac.jp

【はじめに】IoT (Internet of things)社会の実現に向けて、ゼーベック効果による熱電発電をはじめとする、 エナジー・ハーベスティング技術に関する研究が近年活発化している。近年、Si ナノワイヤが優れた熱電 性能指数を示すことが明らかにされ^[1]、Si-CMOS プロセスとの親和性の高い熱電材料として注目されている^[2,3]。 また、古くから高温領域で優れた熱電性能を示すことが知られている SiGe も Si-CMOS プロセスで用いられ る材料であり、Si と同様に細線化することでさらなる熱電性能の向上も期待される。我々はこれまで、 急速溶融成長法で作製した組成傾斜を有する SiGe ワイヤの熱電性能を評価してきた^[4,5]。今回、長さの 異なる SiGe ワイヤの熱電発電量を比較した。

【実験】作製した微小熱電デバイスは、組成傾斜を有するSiGeワイヤの両端が、Niの電極パッドに接続さ れた構造となっている(Fig.1)。ワイヤ幅 W_{wire} は3 μ mとし、ワイヤの長さ L_{wire} は10 μ mと50 μ mの2種類を 用意した。デバイスの作製手順を以下に示す。まずシリコン窒化膜上に、アイランド状に加工したGaド ープ多結晶Si層を50 nm形成し、MBE法によりa-Si0 15Ge0 85膜を100 nm堆積し、ワイヤ状にパターニング した。その後PECVDでSiO₂キャップ層を1µm堆積した後、最高温度1100℃、N₂雰囲気下で熱処理を行い、

急速溶融成長法により組成傾斜型SiGeワイヤを形成した。本研究では不純物ドーピングは行なっていな い。

熱電発電測定では、SiGeワイヤの両端に温度差を印加した状態で、-0.2 nA~+0.2nAの範囲で定電流を印加してI-V特性を測定し、そこから内挿 して開放電圧 (Voc)を求めた。また、顕微サーモグラフィカメラにより、 ワイヤ両端の温度差 (ΔT_{wire})を求めた。以上の方法で測定した V_{oc} と ΔT_{wire} から、SiGeワイヤの実効的なゼーベック係数を評価した。

【結果】Fig. 2に熱電測定で得られた、SiGeワイヤの開放電圧-外部印加温 度差 (Voc-ΔT)特性を示す。温度差が増大するにつれてVocが増大する傾 向が確認された(Fig.2)。これは、印加温度差ΔTの増大とともに、ワイヤ 両端の温度差 ΔT_{wire} も増大し、 V_{oc} (= S ΔT_{wire})が増大したためである。前 回我々は、熱起電流 (Ire)を直接測定することによって、SiGeワイヤの 熱電特性を評価した^[4]。しかし*I_{TE}は~10⁻²* μA/cm程度と小さく、測定回 路のノイズに影響を受けやすいため、ΔT-ITEの測定結果のばらつきが大 きかった^[4]。これに対して今回は、測定回路のノイズの影響が小さいVoc を測定した。その結果、ΔTとVoc のリニアな関係性が明瞭に確認された (Fig.2)。印加温度差 ΔT =25Kの温度差を付与した場合、測定された V_{oc} と ΔTwineから、SiGeワイヤのゼーベック係数は+9.3 μV/Kと見積もられた ^[5]。以前報告した値 (+24 µV/K)^[4]と大きさは異なるが、P型の特性を示 した点は一致している。ノンドープSiGe混晶のキャリアタイプはP型で あり、正のゼーベック係数が測定されたことは妥当といえる。このゼ ーベック係数のナノワイヤ長Lwire依存性をFig.3に示す。Lwireの縮小につ れてゼーベック係数が増大する傾向が確認された。この傾向は、Siナノ ワイヤでも繰り返し観測されている^[5,6]。最大発電量Pmaxは通常内部抵 抗に反比例する。すなわち、ナノワイヤの場合はLwineが短くなるほど Pmaxが増大するが、今回得られた結果では、ゼーベック係数のナノワイ ヤ長Lwire依存性も加わって、内部抵抗の変化のみから予想される発電量 の増大傾向をさらに上回った (Fig.3)。これらの結果は、SiGeワイヤを 用いた微小熱電発電デバイスにおいても、Siナノワイヤの場合と同じ く微細化・高集積化によって高出力化できることを示している。本研 究はJST-CREST (PMJCR15Q7)、JSTさきがけ (JPMJPR15R2)および六研 連携プロジェクト(文部科学省)の支援により実施された。PECVD-SiO2 成膜にご協力頂いた角田功先生(熊本高専)に御礼申し上げます。

[1] A. I. Hochbaum, et al., Nature, 451, 163 (2008). [2] M. Totaro et al., Microelectronic Engineering, 97, 157 (2012). [3] G. Pennelli, Beilstein J. Nanotechnol., 5. 1268 (2014).[4] S. Hashimot et al., IEEE Electron Devices Technol. Manuf. Conf. (EDTM), 283-285, (2018). [5] T. Kumada et al., EDIT (2019). [6] T. Zhan et al., Sci. Technol. Adv. Mater., 19, 1, 443-453, (2018).



Si Substrate Fig.1 Schematic of fabricated planar Micro Thermoelectric Generator of laterally graded SiGe wires.



Fig.2 ΔT_{wire} - V_{oc} characteristics of SiGe wires^[5].



Fig.3 Lwire-S and P characteristics of SiGe wires. Pexp. and Pcalc are the measured power and predicted power from resistance, respectively.